

# 2025年3月期 第2四半期（2024年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2024年11月12日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）

# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

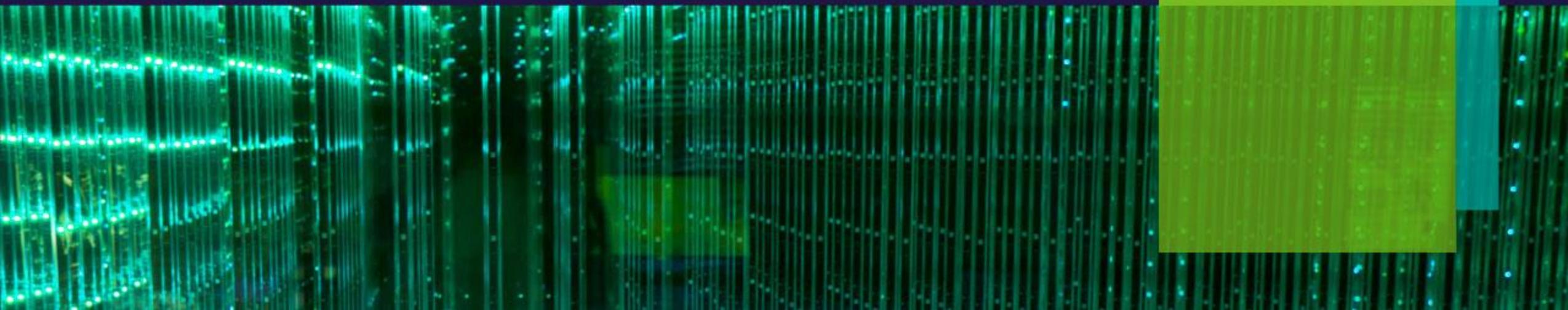
- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

# 第2四半期 連結決算の概要

2024年11月12日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー  
川本 弘



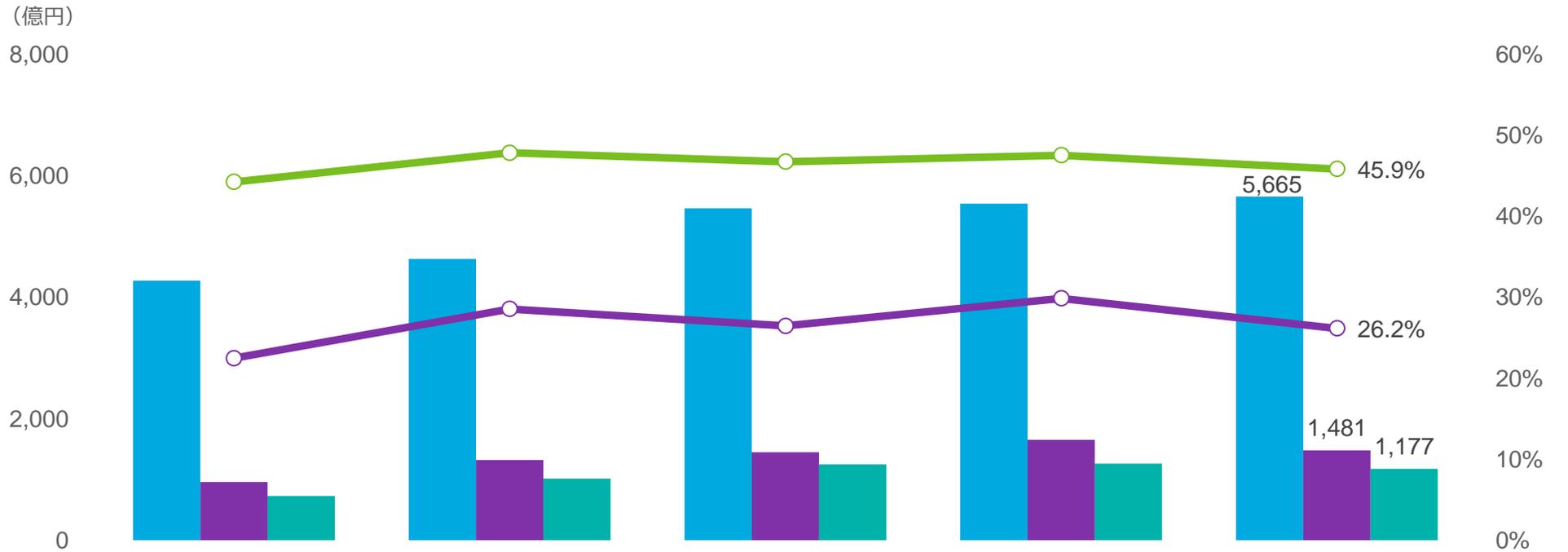
# 損益状況（四半期）

（億円）

	FY2024			FY2025		vs. Q1 FY2025	vs. Q2 FY2024
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
売上高	4,278	4,636	5,472	5,550	5,665	+2.1%	+32.4%
売上総利益	1,897	2,221	2,561	2,640	2,599	-1.5%	+37.0%
売上総利益率	44.3%	47.9%	46.8%	47.6%	45.9%	-1.7pts	+1.6pts
販管費	935	896	1,108	982	1,117	+13.7%	+19.4%
営業利益	961	1,324	1,452	1,657	1,481	-10.6%	+54.1%
営業利益率	22.5%	28.6%	26.5%	29.9%	26.2%	-3.7pts	+3.7pts
税金等調整前当期純利益	981	1,344	1,578	1,672	1,536	-8.2%	+56.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	731	1,015	1,249	1,261	1,177	-6.7%	+60.9%
研究開発費	510	497	584	534	620	+16.1%	+21.6%
設備投資額	176	318	329	239	533	+122.2%	+202.1%
減価償却費	125	138	153	132	145	+9.9%	+15.3%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

# 損益状況（四半期）



	FY2024			FY2025	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
■ 売上高	4,278	4,636	5,472	5,550	<b>5,665</b>
■ 営業利益	961	1,324	1,452	1,657	<b>1,481</b>
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	731	1,015	1,249	1,261	<b>1,177</b>
○ 売上総利益率	44.3%	47.9%	46.8%	47.6%	<b>45.9%</b>
○ 営業利益率	22.5%	28.6%	26.5%	29.9%	<b>26.2%</b>

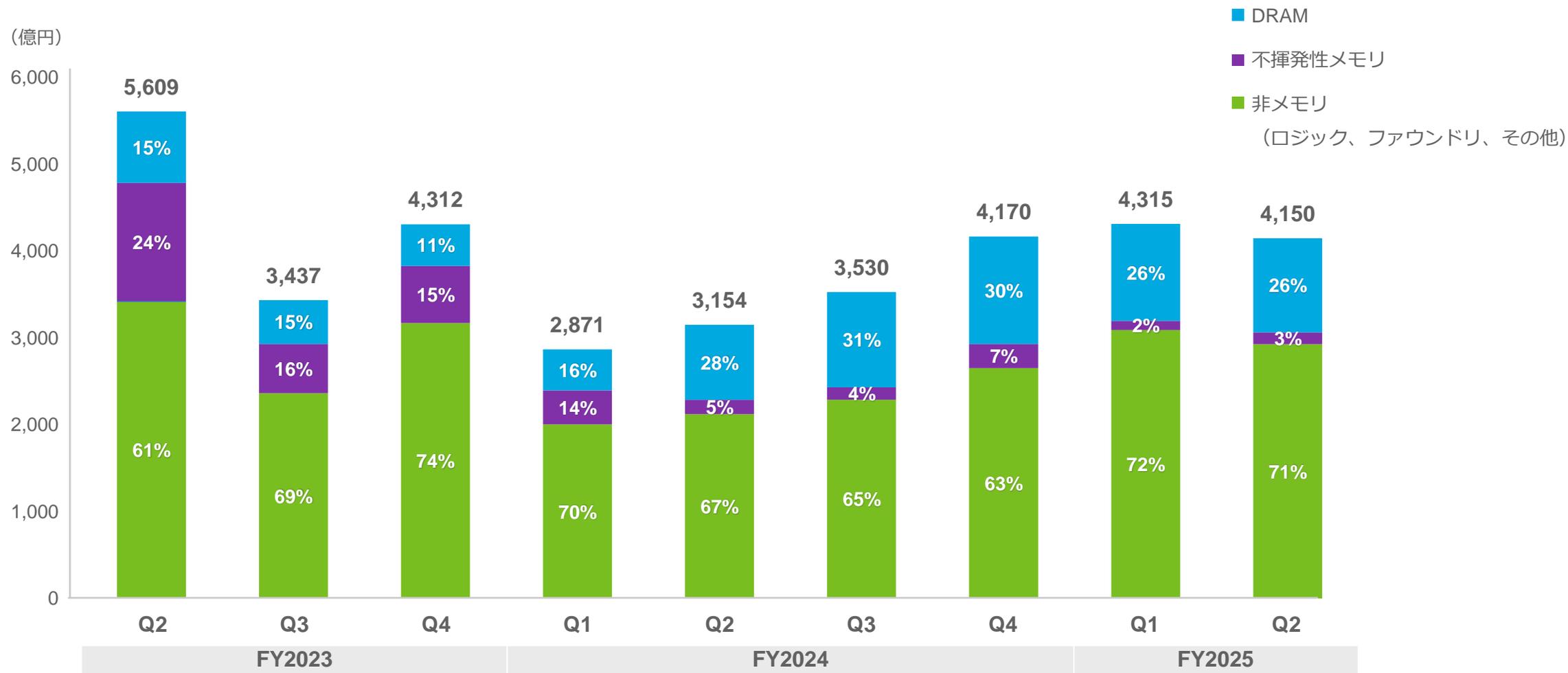
# 損益状況（半期）

（億円）

	FY2024		FY2025	vs. FY2024 H2	vs. FY2024 H1	(ご参考)
	H1	H2	H1			8月8日発表 FY2025 H1 予想
売上高	8,195	10,109	<b>11,216</b>	+10.9%	+36.9%	11,000
売上総利益	3,520	4,782	<b>5,239</b>	+9.6%	+48.8%	5,040
売上総利益率	43.0%	47.3%	<b>46.7%</b>	-0.6pts	+3.7pts	45.8%
販管費	1,734	2,005	<b>2,100</b>	+4.7%	+21.1%	2,160
営業利益	1,785	2,776	<b>3,139</b>	+13.0%	+75.8%	2,880
営業利益率	21.8%	27.5%	<b>28.0%</b>	+0.5pts	+6.2pts	26.2%
税金等調整前当期純利益	1,811	2,923	<b>3,208</b>	+9.8%	+77.1%	2,900
親会社株主に帰属する当期純利益	1,374	2,264	<b>2,439</b>	+7.7%	+77.4%	2,180
研究開発費	946	1,081	<b>1,154</b>	+6.7%	+22.0%	1,210
設備投資額	570	648	<b>773</b>	+19.3%	+35.6%	-
減価償却費	231	291	<b>277</b>	-5.0%	+19.5%	-

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

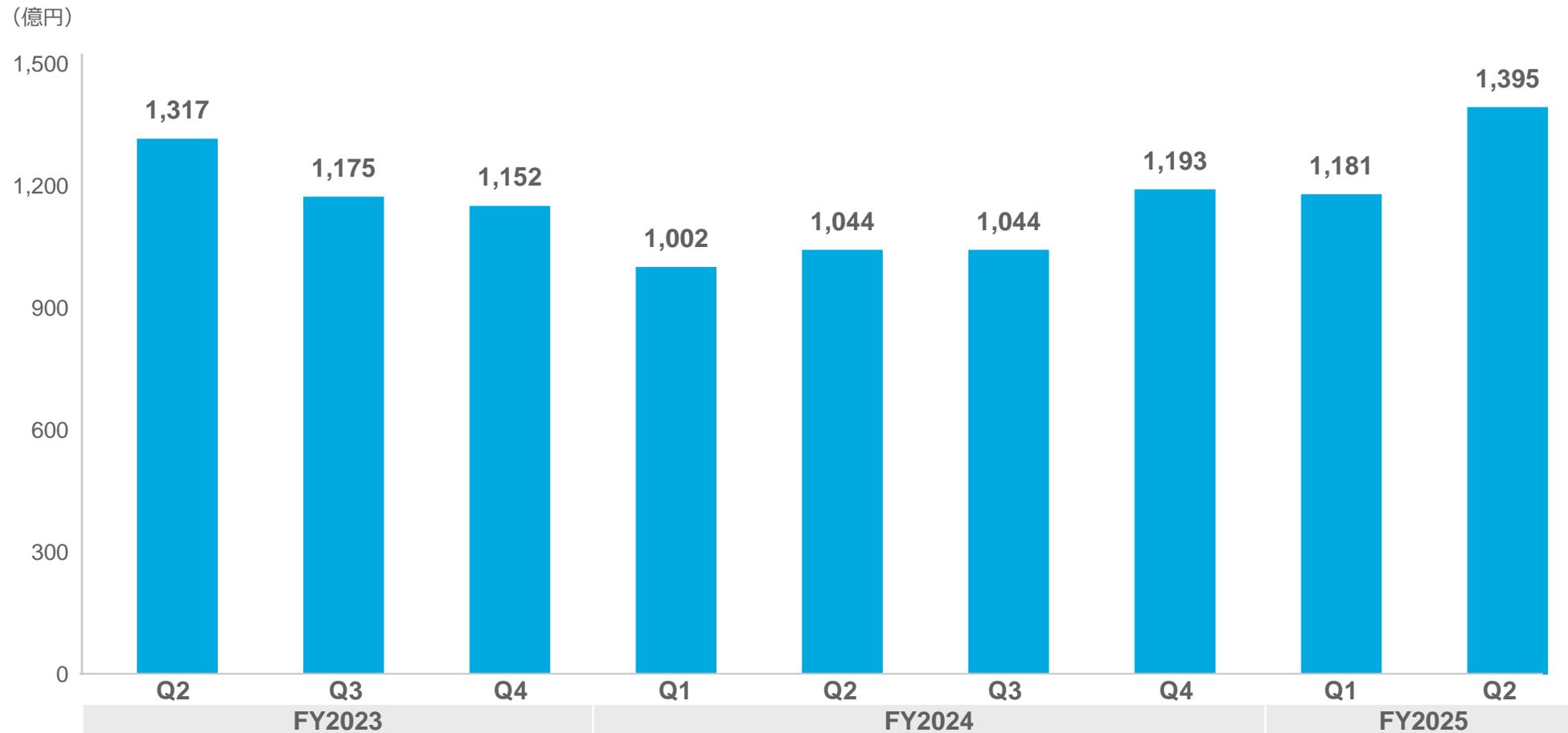
# SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



\*1 SPE : 半導体製造装置

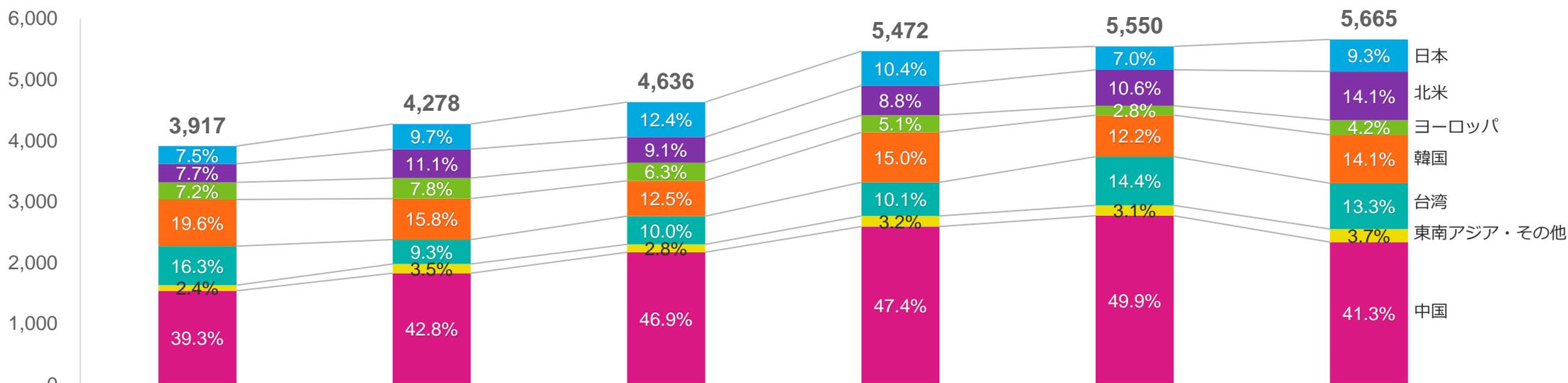
\*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

# フィールドソリューション売上高（四半期）



# 地域別売上高構成比 (FY2024 Q1~FY2025 Q2)

(億円)



	FY2024				FY2025	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
日本	295	412	574	567	385	526
北米	301	474	421	483	590	799
ヨーロッパ	281	335	294	281	155	238
韓国	767	674	582	820	678	795
台湾	639	399	463	552	800	753
東南アジア・その他	92	151	127	175	170	212
中国	1,539	1,829	2,172	2,591	2,770	2,339

# 貸借対照表（四半期）

## 資産

(億円)



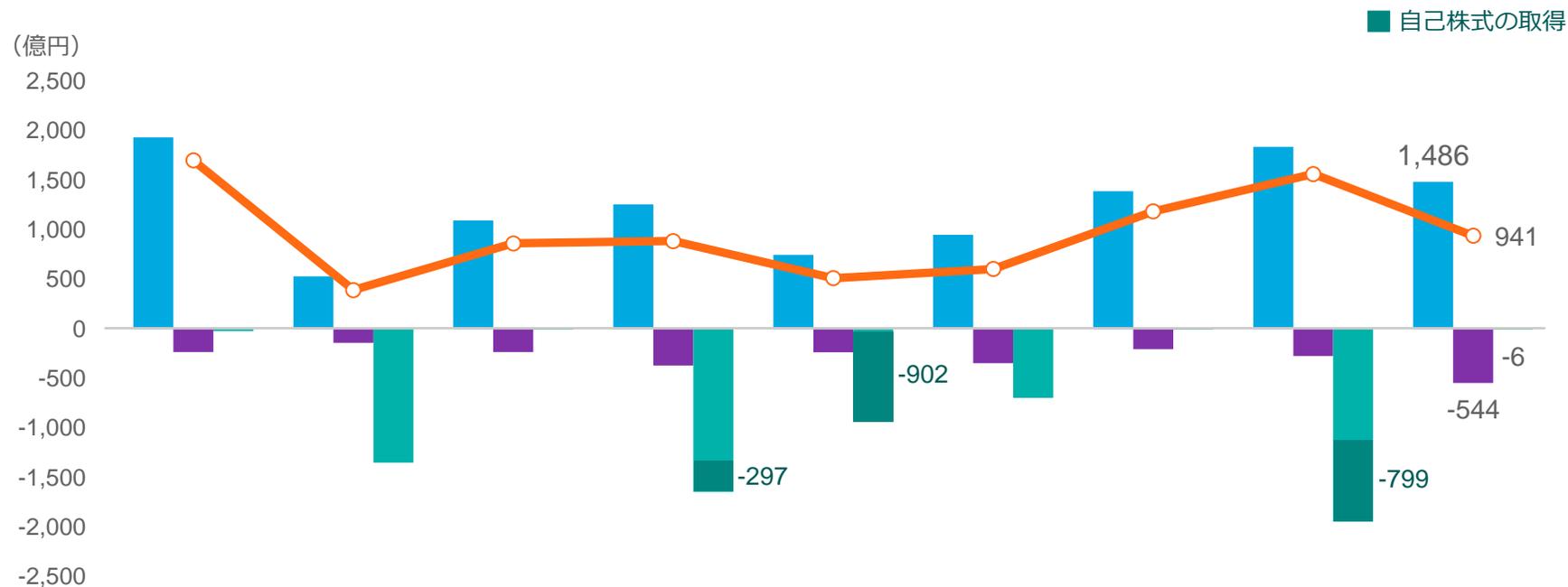
## 負債・純資産

(億円)



\*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

# キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023			FY2024			FY2025		
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
■ 営業キャッシュ・フロー	1,934	532	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837	1,486
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-231	-138	-231	-368	-234	-344	-203	-273	-544
■ 財務キャッシュ・フロー	-21	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944	-6
○ フリーキャッシュ・フロー*2	1,702	393	865	888	514	606	1,187	1,564	941
■ 手元資金残高*3	4,846	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385	5,255

\*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

\*2 フリーキャッシュ・フロー＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

\*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

# 事業環境および業績予想

2024年11月12日

代表取締役社長・CEO  
河合 利樹



## 事業環境 (2024年11月時点でのWFE市場の見方)

### ■ CY2024 : \$100B強と予測。期初の想定を上回る勢い

- 旺盛なAIサーバー需要。AI搭載型PC・スマホ向け需要を見込んだ先行投資も活発
  - AIサーバー向け投資比率 15% (昨年比1.5倍に拡大)
  - AI搭載型PC・スマホ向け投資比率 15%
  - 従来型サーバー・PC・スマホ向け投資比率 35%

### ■ CY2025 : 二桁成長を期待

- AI比率上昇。DRAMのさらなる拡大に加え、NANDも在庫調整が進捗し投資再開。先端ロジック/ファウンドリ向けの設備投資も増加し、成熟向け投資の一服感をオフセット
  - AIサーバー向け投資比率 20%
  - AI搭載型PC・スマホ向け投資比率 20%
  - 従来型サーバー・PC・スマホ向け投資比率 30%

大容量・超高速・低消費電力の実現に向けた技術革新が進展。GAA<sup>\*1</sup>・ Backside PDN<sup>\*2</sup>・ HBM<sup>\*3</sup>や、三次元実装におけるテスト工程など、TELの事業機会は拡大

\*1 GAA (Gate All Around)

\*2 Backside PDN (Power Delivery Network)

\*3 HBM (High Bandwidth Memory)

: トランジスタのチャネル全面をゲートで覆った構造

: 電源供給配線をシリコンの裏面に配置する構造

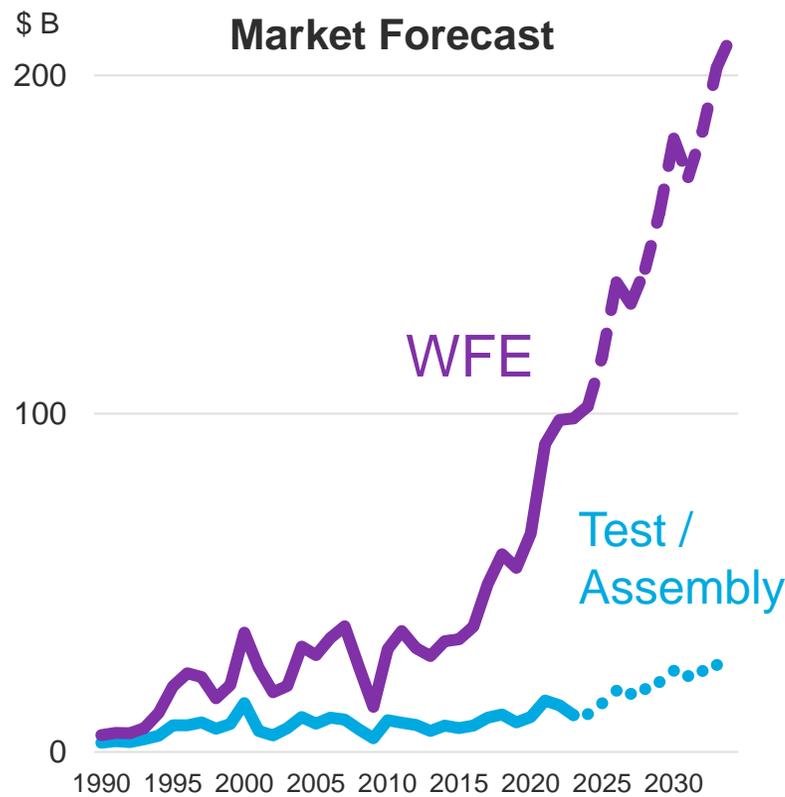
: 高帯域幅DRAM

# FY2025 Q2 事業進捗

- 売上・利益等、すべての指標において計画を達成
  - Q2 : 売上高 5,665億円、営業利益 1,481億円、営業利益率 26.2%
  - H1 : 売上高 1兆1,216億円、営業利益 3,139億円、営業利益率 28.0%
- 先端ロジック、HBM用途のDRAM、Advanced Packaging用途の引き合いが増加
  - 先端向け量産投資の本格化に伴い、新製品比率が上昇
  - 通期で過去最高の売上高、売上総利益、売上総利益率、営業利益、当期純利益およびEPSを見込む
- 戦略製品によるPOR\*獲得・開発評価も順調に進捗
  - DRAM向けHigh-k成膜装置、NAND向け高生産性の枚葉洗浄装置、HBM向けTemporary bonder、最先端ロジック（Backside PDN）Bonder、DRAM向けProberなどでPORを獲得。  
また、Advanced packaging（SoC）向けBonderにおいては、開発PORを獲得
  - NAND向け極低温エッチングにおいても、量産POR獲得に向けて著しい進捗

\* POR（Process of Record） : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

# ScalingとPackaging/Testにより拡大するTELの事業機会



Source: TechInsights

<p><b>Logic: GAA, BSPDN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EUV Coater/Developer</li> <li>Gas Chemical Etch</li> <li>Conductor Etch</li> <li>PVD Metal Overburden</li> <li>CFET/Inner Spacer 埋め込み膜用プラズマCVD</li> <li>両面スクラバ</li> <li>裏面/ベベル洗浄</li> <li>パターンシェーピング</li> </ul>	<p><b>DRAM: DDR5, 3DDRAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EUV Coater/Developer</li> <li>Capacitor Mold Etch 大手独占</li> <li>Batch High-k Capacitor成膜</li> <li>PVD Metal Hard Mask</li> <li>超臨界洗浄</li> <li>裏面/ベベル洗浄</li> </ul>	<p><b>Scaling</b></p> <p><b>NAND: Beyond 4xx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slit Etch 大手独占</li> <li>極低温エッチング</li> <li>Batch Mo成膜</li> <li>Batch洗浄 WL Separation</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Bonder</li> <li>Laser Tool</li> </ul> <p><b>Logic Packaging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interposer, Polyimide, PR Coater/Developer</li> <li>TDV Etch</li> <li>Batch High-k Capacitor成膜</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Bonder</li> <li>Laser Tool</li> </ul> <p><b>HBM Packaging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polyimide, PR Coater/Developer</li> <li>HBM向け 配線Etch</li> <li>エアロゾル洗浄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Bonder</li> <li>Laser Tool</li> </ul> <p><b>Packaging / Test</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Bonder</li> <li>Laser Tool</li> </ul> <p><b>最先端Logic/Memory テスト工程</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prober 昨年比 ~2倍の売上見込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temporary Bonder/Debonder</li> </ul>	

中期経営計画達成に向け、事業は順調に進捗。2025年2月26日にIR Dayを実施予定

# FY2025 業績予想

# FY2025 業績予想

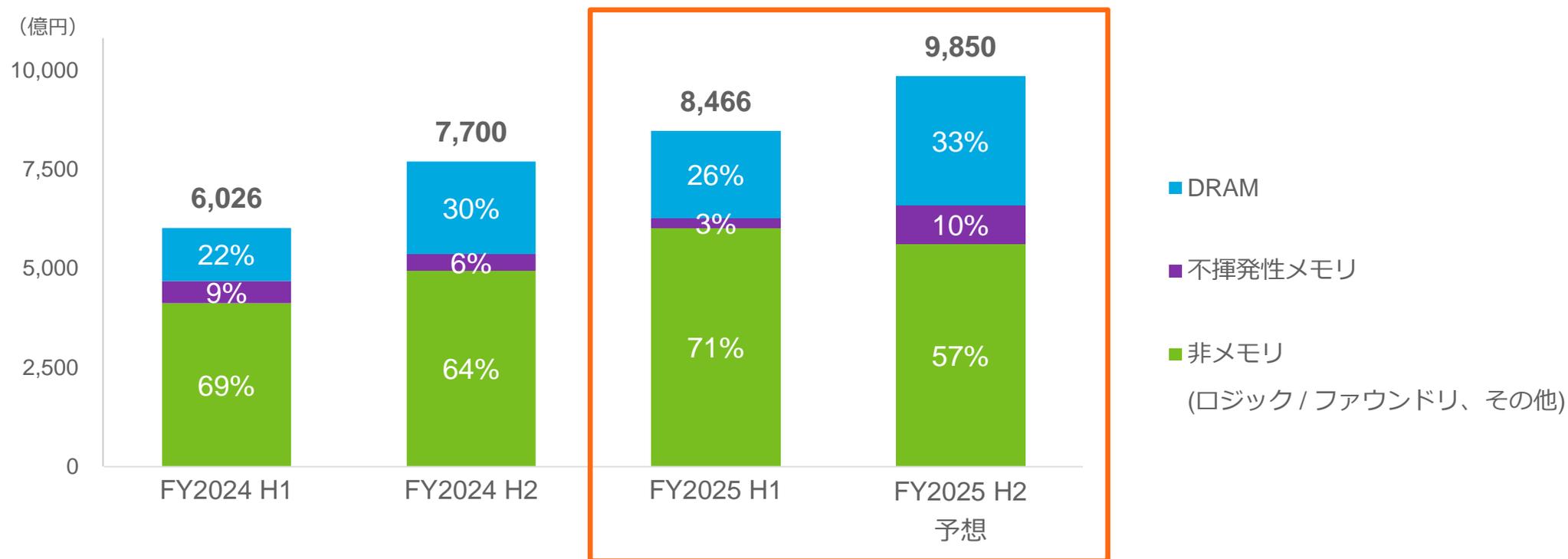
(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025				
		H1 (実績)	H2 (新予想)	通期 (新予想)	通期 修正額	通期 YoY
売上高	18,305	11,216	12,783	24,000	+1,000	+31.1%
売上総利益 売上総利益率	8,302 45.4%	5,239 46.7%	6,050 47.3%	11,290 47.0%	+570 +0.4pts	+36.0% +1.6pts
販管費	3,740	2,100	2,389	4,490	+40	+20.1%
研究開発費	2,028	1,154	1,386	2,540	+10	+25.2%
研究開発費以外の販管費	1,711	945	1,003	1,950	+30	+14.0%
営業利益 営業利益率	4,562 24.9%	3,139 28.0%	3,660 28.6%	6,800 28.3%	+530 +1.0pts	+49.1% +3.4pts
税金等調整前当期純利益	4,734	3,208	3,701	6,910	+610	+46.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	2,439	2,820	5,260	+480	+44.5%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	528.67	-	1,140.67	+103.73	+356.92

業績予想を再度上方修正。市場成長を大きくアウトパフォーム

# FY2025 SPE新規装置売上予想

## アプリケーション別売上構成比



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

## FY2025H2は過去最高の半期売上を予想

# FY2025 研究開発費・設備投資計画

## 新開発棟

成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県韮崎市  
2023年7月 竣工

## 東北生産・物流センター

成膜装置



岩手県奥州市  
2025年秋 竣工予定

## 新開発棟

コータ/デベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置



熊本県合志市  
2025年夏 竣工予定

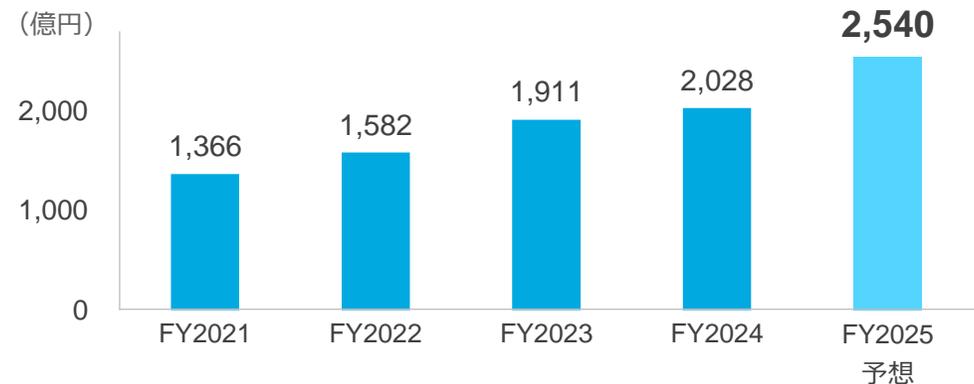
## 新開発棟

エッチング装置

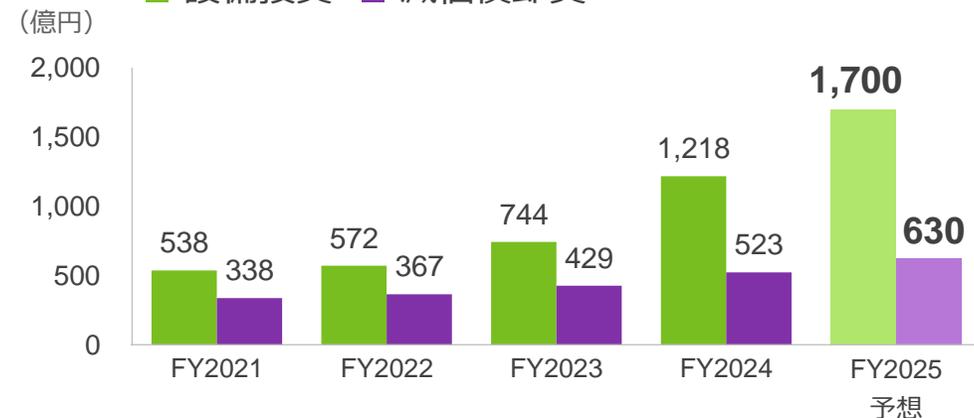


宮城県黒川郡  
2025年春 竣工予定

## ■ 研究開発費



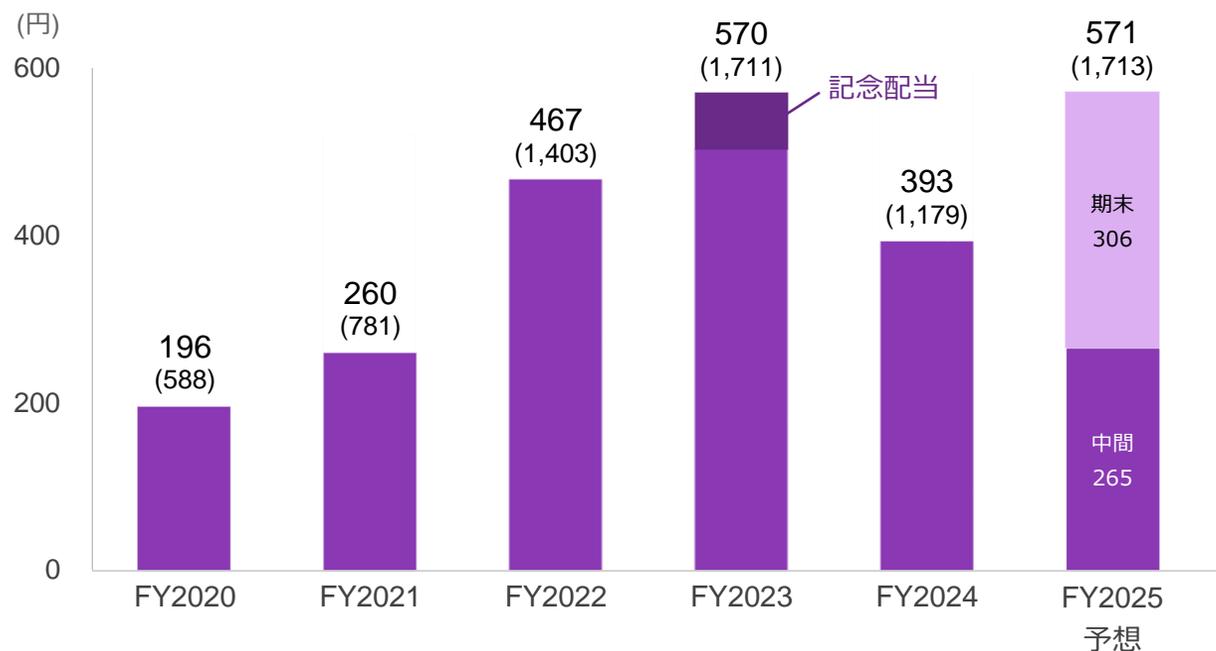
## ■ 設備投資 ■ 減価償却費



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

# FY2025 配当予想

## 1株当たり配当金



## 当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円\*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

\*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は571円を予定

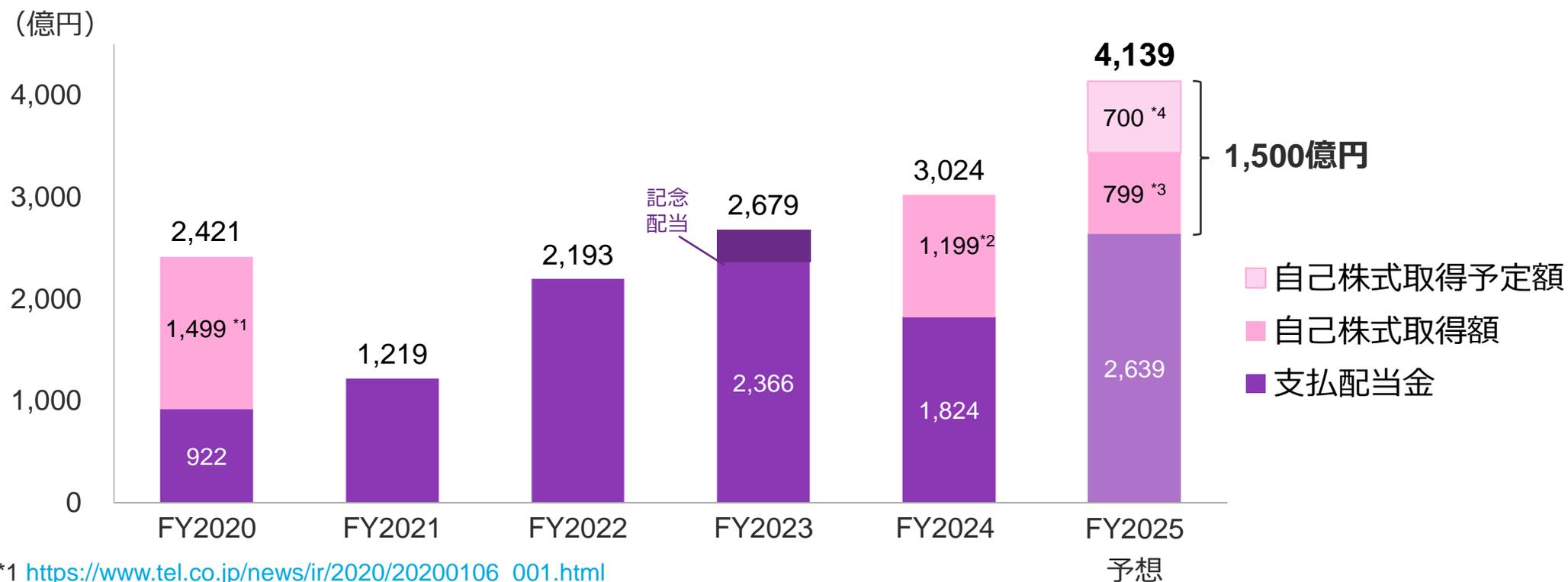
## 自己株式の取得について

# 最大700億円の自己株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 350万株（上限）  
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 0.8%）
- 株式の取得価額の総額 : 700億円（上限）
- 取得する期間 : 2024年11月13日～2025年1月31日

キャッシュ創出力と必要手元資金、成長投資資金を考慮し、  
今後も機動的にバランスシート・マネジメントをおこないます

# 総還元額



\*1 [https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106\\_001.html](https://www.tel.co.jp/news/ir/2020/20200106_001.html)

\*2 [https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002\\_001.pdf](https://www.tel.co.jp/news/ir/2023/sb15um000000009e-att/20231002_001.pdf)

\*3 [https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/tln2lq00000000c0-att/20240701\\_001.pdf](https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/tln2lq00000000c0-att/20240701_001.pdf)

\*4 [https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/bknhch00000000ik-att/20241112\\_003.pdf](https://www.tel.co.jp/news/ir/2024/bknhch00000000ik-att/20241112_003.pdf)

自己株式取得と合わせ、過去最高レベルの総還元額を見込む

**TEL**

**TOKYO ELECTRON**

# 本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複製、または第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

**TEL** および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。